

3A 80V $T_{jw}150^{\circ}\text{C}$ ショットキーバリアダイオード
Schottky Barrier Diode

SMD Type

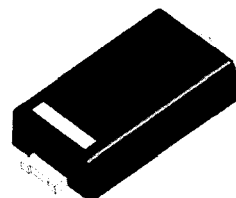
NA03HSA08

仕様書

日本インター株式会社
Nihon Inter Electronics Corporation

Specification

構造 ショットキーバリアダイオード
Construction Schottky barrier diode
用途 高周波整流用
Application High frequency rectification

■ 最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^{\circ}\text{C}$: unless otherwise specified)

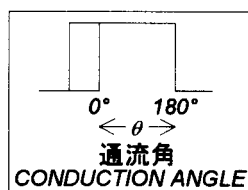
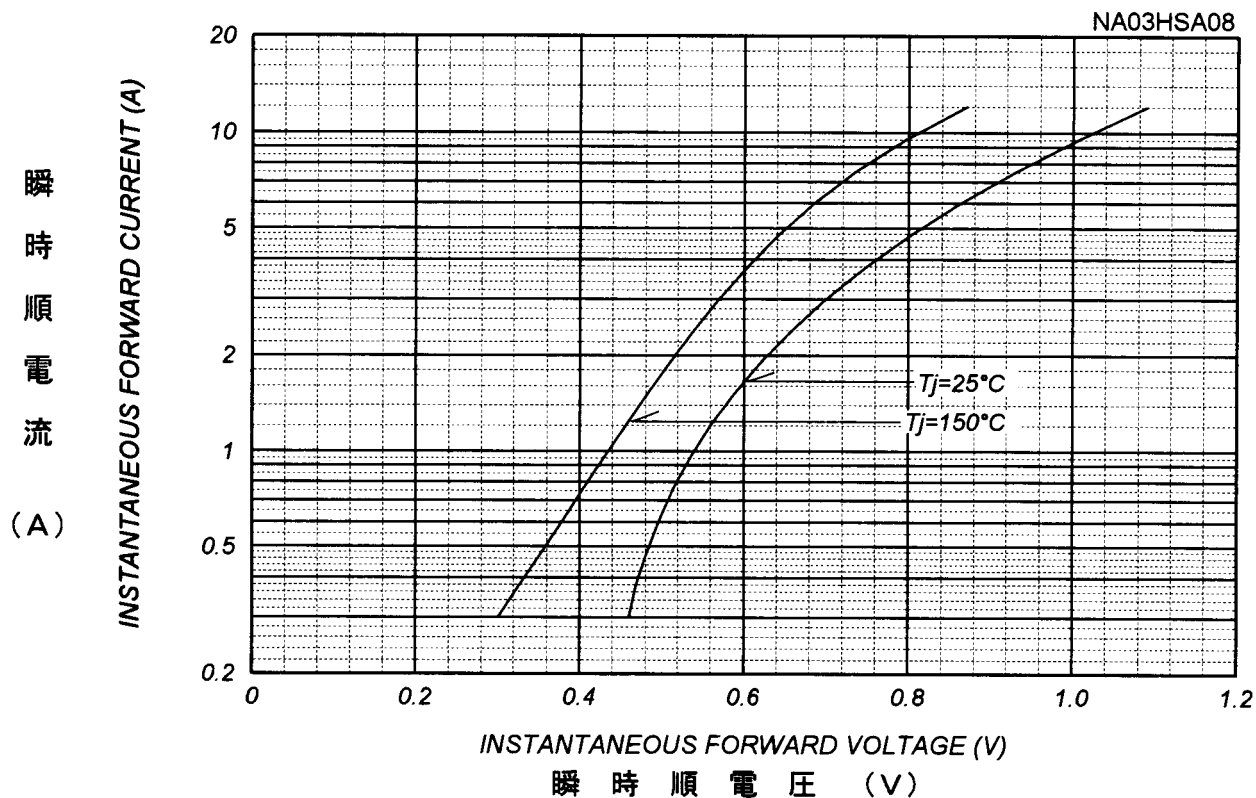
Item	Symbol	Condition	Max. Rated value	Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		80	V
平均整流電流 Average rectified forward current	I_O	50Hz 正弦半波 50Hz half sine wave 抵抗負荷 Resistance load	$T_l=118^{\circ}\text{C}$ $V_{RM}=40\text{V}$ (T_l :Lead Temperature)	A
			$T_a=30^{\circ}\text{C}$ *1 $V_{RM}=40\text{V}$	
実効順電流 R.M.S Forward current	I_{FRMS}		4.71	A
サージ順電流 Surge forward current	I_{FSM}	50Hz 正弦半波 1 サイクル 非くり返し 50Hz half sine wave 1cycle, non-repetitive	80	A
動作接合温度範囲 Operating junction temperature range	T_{jw}		$-40\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$
保存温度範囲 Storage temperature range	T_{stg}		$-40\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$

■ 電氣的・熱的特性 ELECTRICAL / THERMAL CHARACTERISTICS

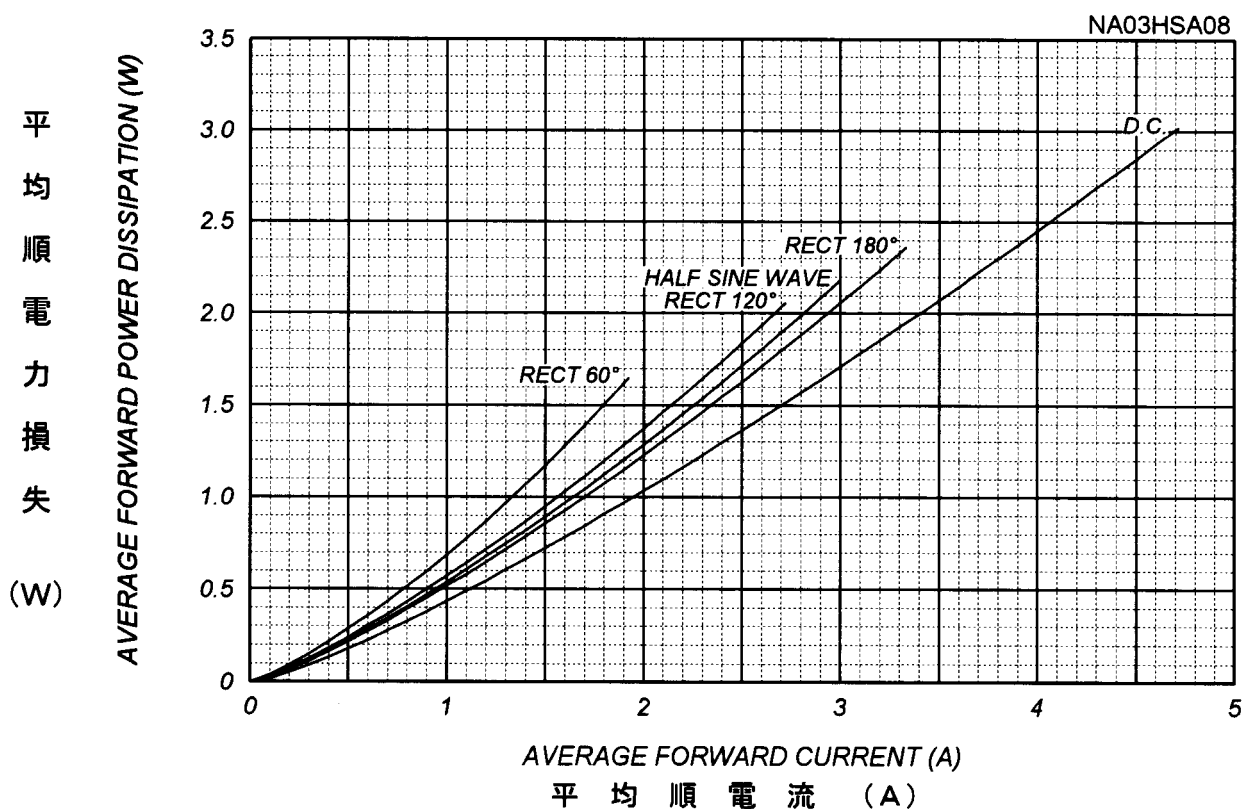
Item	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak reverse current	I_{RM}	$V_{RM}=80\text{V}$ $T_j=25^{\circ}\text{C}$	—	—	100	μA
ピーク順電圧 Peak forward voltage	V_{FM}	$I_{FM}=3\text{A}$ $T_j=25^{\circ}\text{C}$	—	—	0.7	V
熱抵抗 Thermal resistance	$R_{th(j-l)}$	接合部・リード間 Junction to Lead	—	—	13	$^{\circ}\text{C/W}$
	$R_{th(j-a)}$	接合部・周囲間 Junction to Ambient	—	—	130	

*1 : プリント基板実装 / Glass-Epoxy Substrate Mounted (Soldering Land=2.0*1.5mm, 2.0*3.5mm)

順電圧特性 FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE



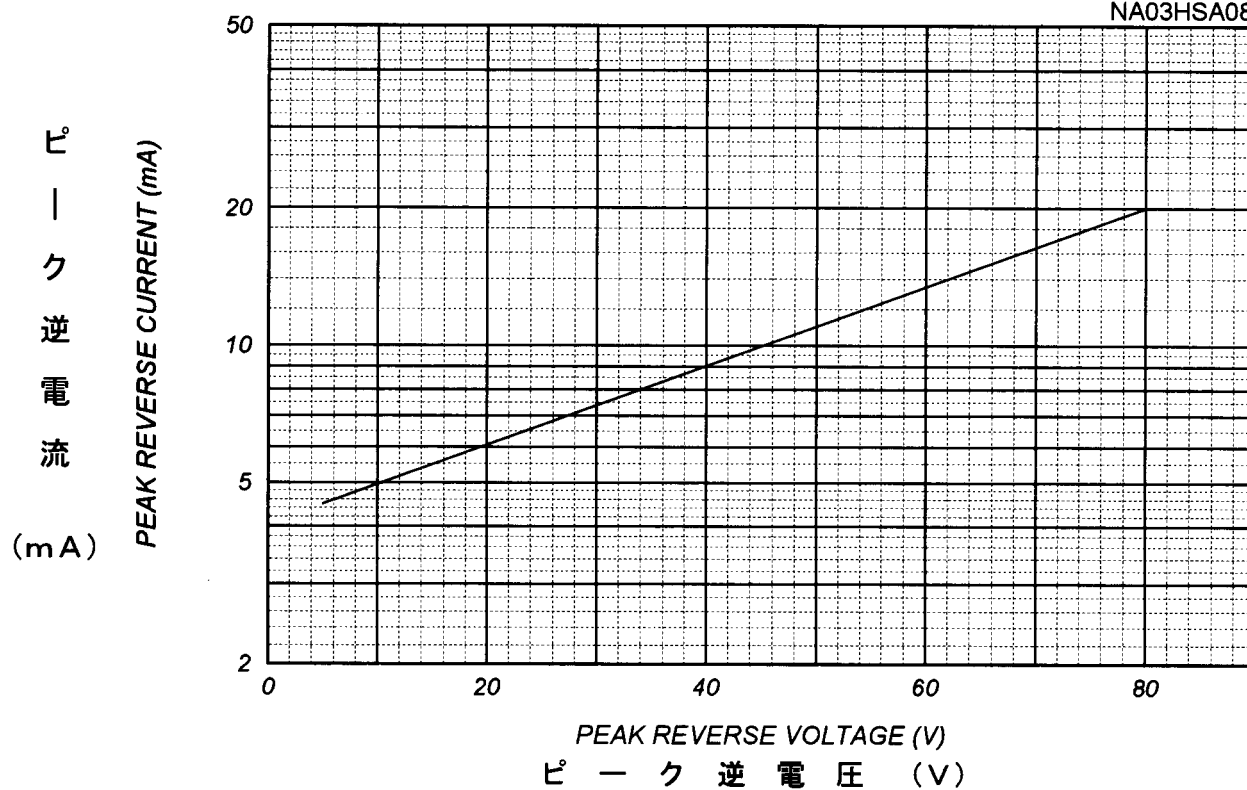
平均順電力損失特性 AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



ピーク逆電流 — ピーク逆電圧特性
 PEAK REVERSE CURRENT VS. PEAK REVERSE VOLTAGE

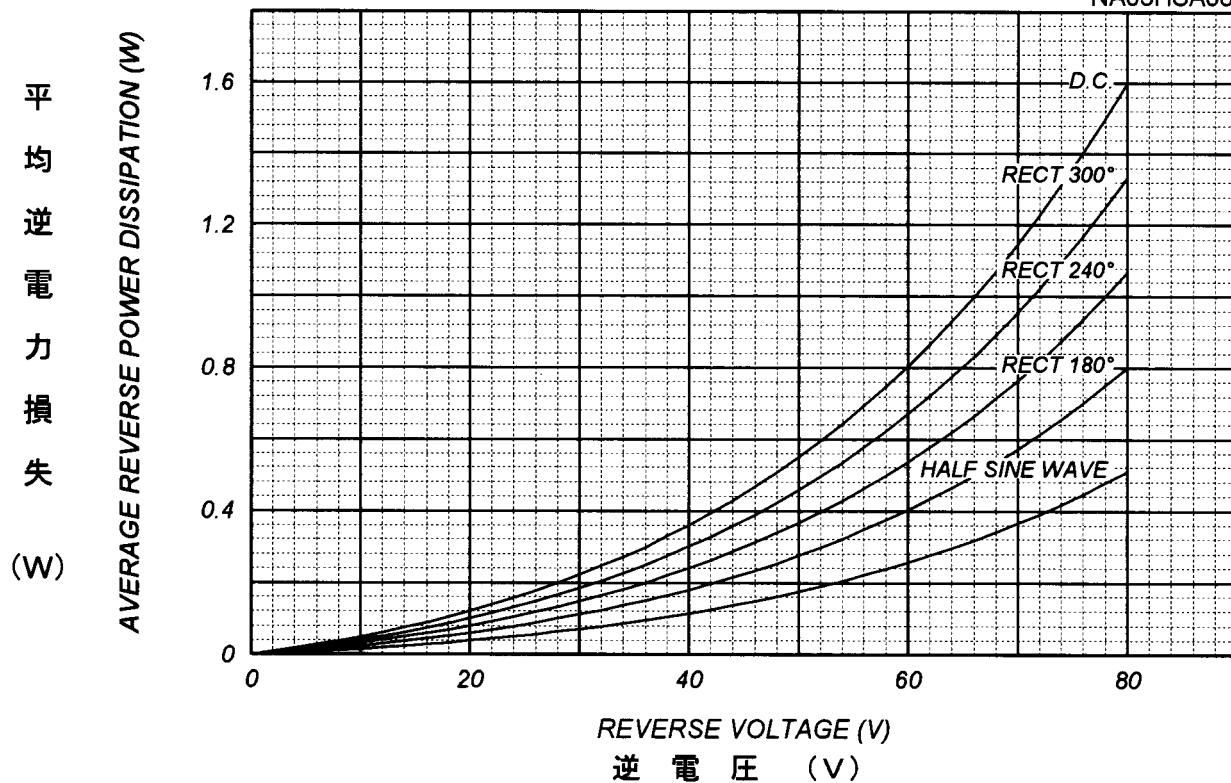
$T_J = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$

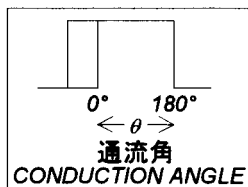
NA03HSA08



平均逆電力損失
 AVERAGE REVERSE POWER DISSIPATION

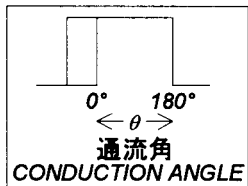
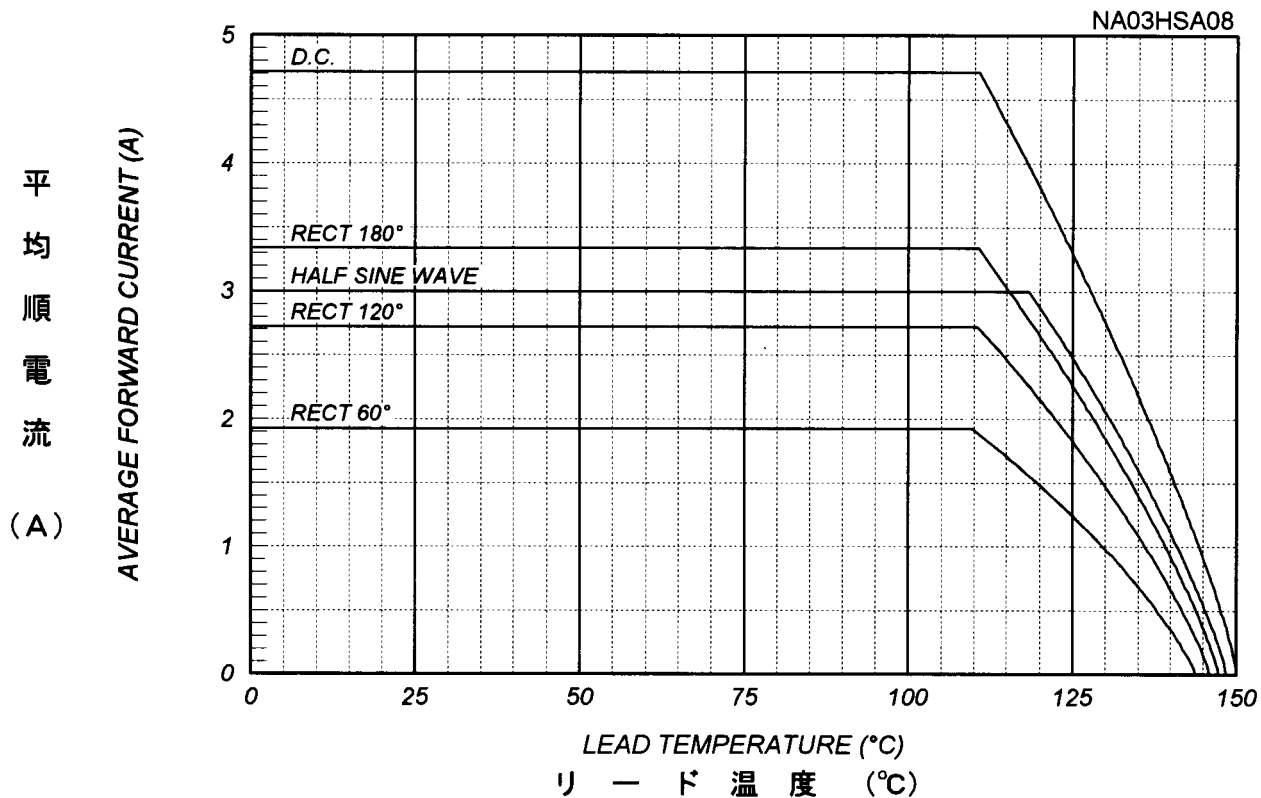
NA03HSA08





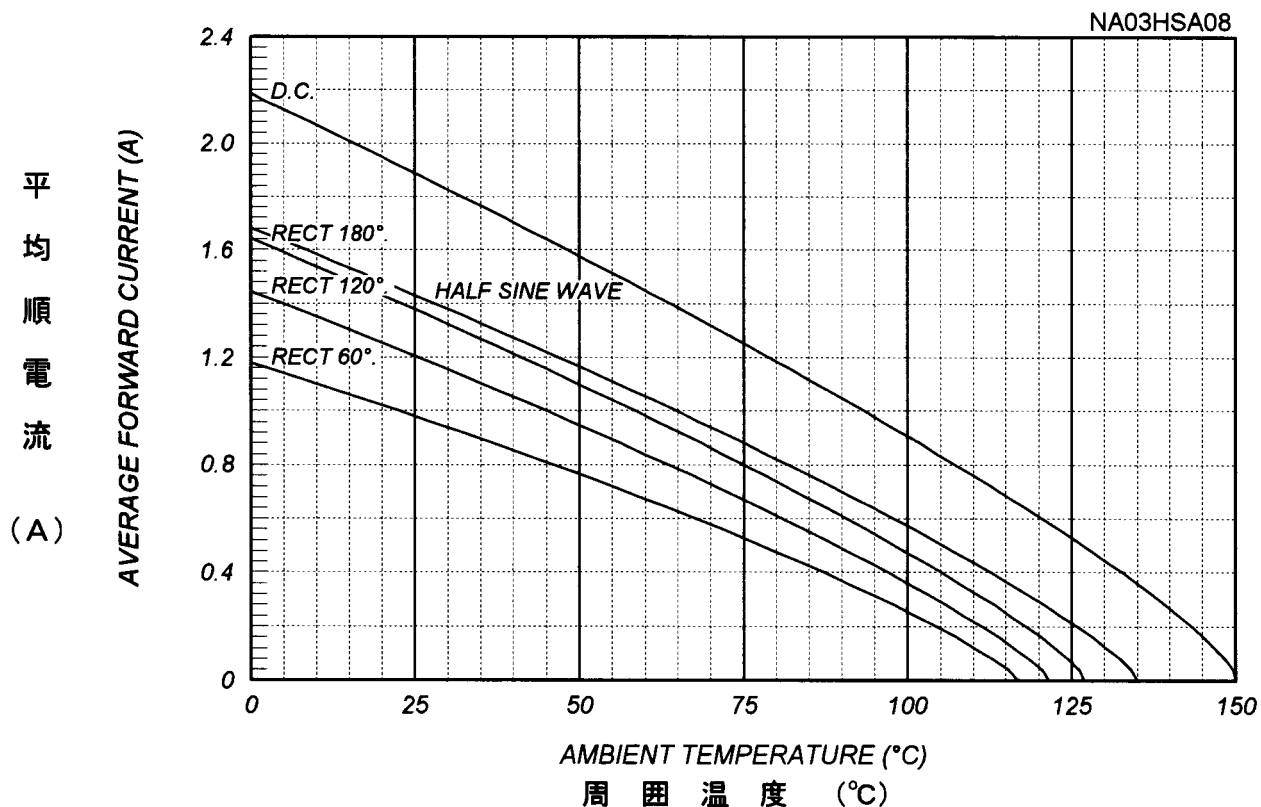
平均順電流－リード温度定格 AVERAGE FORWARD CURRENT VS. LEAD TEMPERATURE

$V_{RM}=40V$



平均順電流－周囲温度定格 AVERAGE FORWARD CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE

Glass-Epoxy Substrate Mounted (Soldering Land=2.0×1.5mm, 2.0×3.5mm), $V_{RM}=40V$



サージ順電流定格 SURGE CURRENT RATINGS

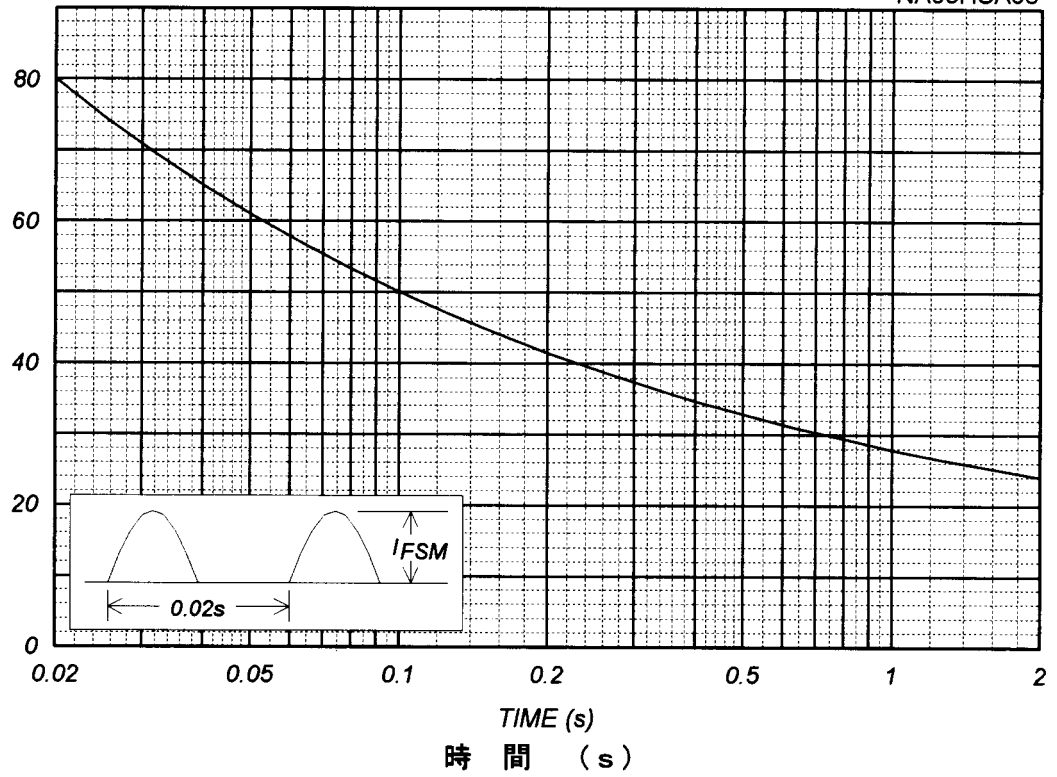
f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, No Load

NA03HSA08

サ
ー
ジ
順
電
流

(A)

SURGE FORWARD CURRENT (A)



接合容量特性 JUNCTION CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE

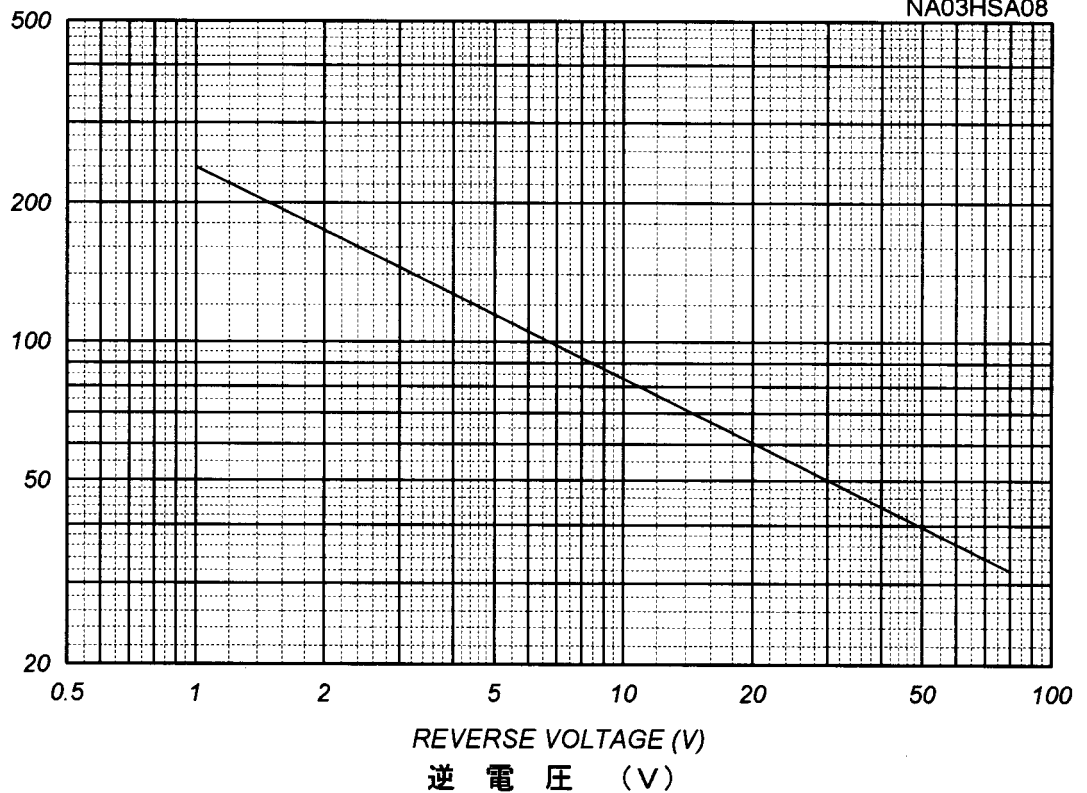
T_j=25°C, V_m=20mV_{RMS}, f=100kHz, Typical Value

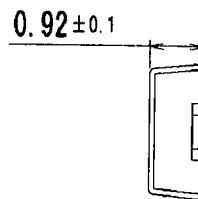
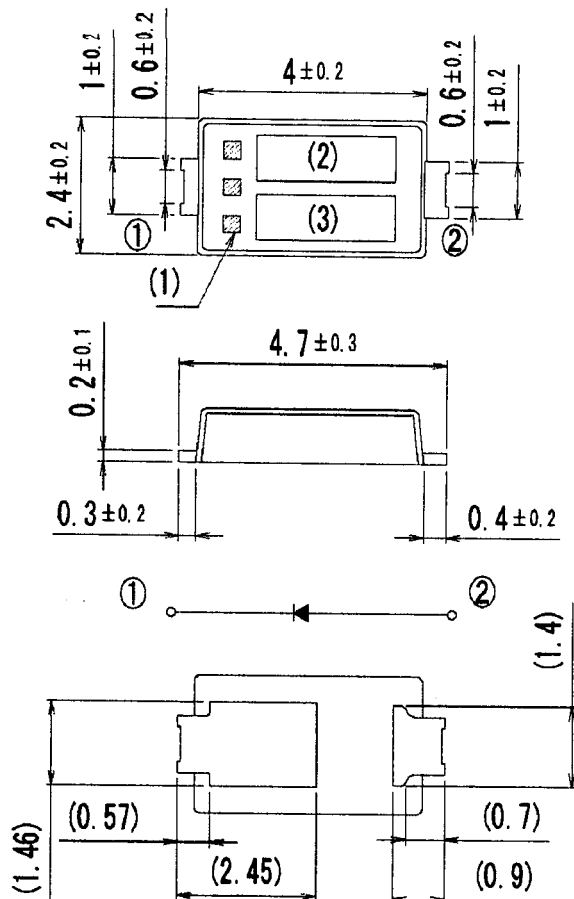
NA03HSA08

接
合
容
量

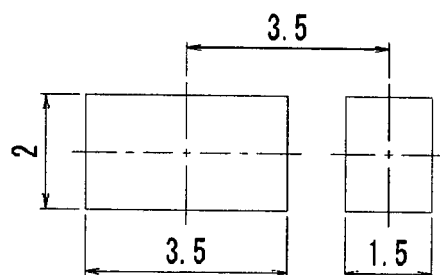
(pF)

JUNCTION CAPACITANCE (pF)





(参考Soldering Pad)



表示 Marking

(1) 極性 Polarity
カソード側 表示 Cathode Band

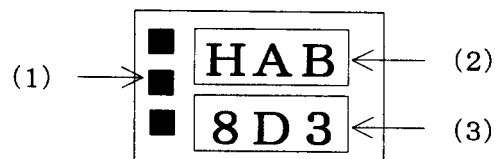
(2) 型名略コード Type Code

Code	型名 Type
HA 6	NA03HSA065
HAB	NA03HSA12

(3) ロット番号 Lot No.

製造年	西暦年代ノ下一桁ヲ表示スル												
製造月	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
管理番号	一桁ノ数字ヲ表示スル												

(例)2008年4月→8D3



材料 Materials

- モールド材 Mold
エポキシ樹脂 (UL 94 V-0 認定品)
Epoxy Resin (UL94V-0 recognized)
- リード端子 Lead
銅+錫メッキ (Sn100%) Cu+Sn plated

質量 Weight : 0.03g